

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 3 区分
【発行日】平成 23 年 10 月 20 日 (2011.10.20)

【公開番号】特開 2011-176531 (P2011-176531A)
【公開日】平成 23 年 9 月 8 日 (2011.9.8)
【年通号数】公開・登録公報 2011-036
【出願番号】特願 2010-38289 (P2010-38289)
【国際特許分類】

H 0 4 R 19/04 (2006.01)

H 0 4 R 1/02 (2006.01)

【F I】

H 0 4 R 19/04

H 0 4 R 1/02 1 0 6

【手続補正書】
【提出日】平成 23 年 8 月 1 日 (2011.8.1)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項 1】

バックチャンバを備えた基板と、
前記バックチャンバの上面開口に対向させて前記基板の上方に設けた振動電極板と、
前記振動電極板に対向し、かつ、音響孔を開口された固定電極板とを備え、
前記振動電極板の変位による前記振動電極板と前記固定電極板の間の静電容量の変化に基づいて電気信号を出力する音響検知素子において、
前記バックチャンバの下面を前記基板によって袋状に塞いでいることを特徴とする音響検知素子。

【請求項 2】

表裏に貫通した貫通孔を有する主基板の裏面に副基板を接合することによって前記基板を形成し、

前記貫通孔の下面を前記副基板で塞ぐことにより前記貫通孔を含む空間によって前記バックチャンバを形成したことを特徴とする、請求項 1 に記載の音響検知素子。

【請求項 3】

前記副基板に前記貫通孔と連通させて凹部を形成し、前記貫通孔と前記凹部によって前記バックチャンバを形成したことを特徴とする、請求項 2 に記載の音響検知素子。

【請求項 4】

前記主基板と前記副基板は、接着剤を用いない方法で接合されていることを特徴とする、請求項 2 に記載の音響検知素子。

【請求項 5】

前記主基板と前記副基板は、互いに線膨張係数がほぼ等しい材質によって形成されていることを特徴とする、請求項 2 に記載の音響検知素子。

【請求項 6】

請求項 1 に記載した音響検知素子の下面を、接着剤によってベース基板の上面に固着させ、前記音響検知素子を覆うようにして前記ベースの上面にカバーを取り付けたことを特徴とする音響センサ。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0012】

このような目的を達成するために、本発明に係る音響検知素子は、バックチャンバを備えた基板と、前記バックチャンバの上面開口に対向させて前記基板の上方に設けた振動電極板と、前記振動電極板に対向し、かつ、音響孔を開口された固定電極板とを備え、前記振動電極板の変位による前記振動電極板と前記固定電極板の間の静電容量の変化に基づいて電気信号を出力する音響検知素子において、前記バックチャンバの下面を前記基板によって袋状に塞いでいることを特徴としている。